

1999 年上海交通大学半导体物理(含晶体结构和能带理论)试题

考研加油站收集整理 <http://www.kaoyan.com>

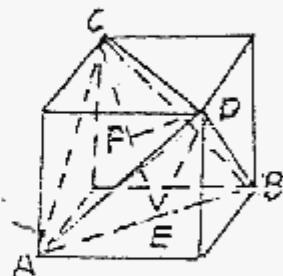
1999 年上海交通大学半导体物理(含晶体结构和能带理论)试题

一、填充题

(15 分)

1. 能带中电子可以用 _____ 描写其状态，电子能量 _____，
电子速度 _____，晶体中电子的所有运动状态都可以由 _____ 来描写，把 _____ 的这个区域叫做 _____。
2. 施主杂质和受主杂质之间有相互抵消作用，通常称为 _____，深能级和晶体缺陷形成的能级一般作为 _____ 中心。
3. 晶体中电子的能量状态遵守 _____ 规律，其分布函数为 _____，它们都是 _____ 和 _____ 的函数。
4. 电子和空穴浓度是对 _____ 状态密度为单位能量间隔内的 _____ 数，其表达式为 _____。
5. 非平衡载流子通过 _____ 而消失， _____ 叫做寿命 τ ，寿命与 _____ 在 _____ 中的位置密切相关，对于强 p 型和强 n 型材料，小注入时寿命 τ_n 为 _____ τ_p 为 _____。
6. _____ 是反映载流子在电场作用下运动难易程度的物理量， _____ 是反映有浓度梯度时载流子运动难易程度的物理量，两者关联式为 _____，称为 _____ 关系式。
7. p-n 结正向偏置时，外加电场 _____ 势垒区内自建电场，因而势垒区内 _____ 占优势，p-n 结反向偏置时，外加电压在势垒区产生的电场和自建电场的方向是 _____ 的， _____ 占优势，由漂移作用形成的电流称为 _____ 电流。

二、试标出由图所示的{111}面围成的正四面体中ABC、ABD、ACD、BCD晶面的晶面指数和AB、BC、CA、BD、CD、DE、FD、EF等晶向的晶向指数。
(15分)



三、设晶格常数为a的一维晶格，导带极小值附近能量 $E_c(k)$ 为

$$E_c(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{3m_0} + \frac{\hbar^2 (k - k_1)^2}{m_0}$$

价带极大值附近能量 $E_v(k)$ 为

$$E_v(k) = \frac{\hbar^2 k_1^2}{6m_0} + \frac{3\hbar^2 k^2}{m_0}$$

设 m_0 为电子质量， $k_1 = \frac{1}{2a}$ ， $a = 5.14 \times 10^{-10} \text{ m}$ ，试求：

(1) 禁带宽度；(2) 导带底电子有效质量；(3) 价带顶电子有效质量；(4) 价带顶电子跃迁到导带底的准动量的变化

($\hbar = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, $m_0 = 9.1 \times 10^{-31} \text{ Kg}$)
(20分)

四、一块掺施主浓度为 $2 \times 10^{16}/\text{cm}^2$ 的硅片，在 920°C 下掺金到饱和浓度。然后经氧化处理，最后此硅片的表面复合中心为 $10^{19}/\text{cm}^2$ 。

试计算体寿命，扩散长度和表面复合速度（假设复合中心均匀分布，金的空穴俘获率

$$\gamma_p = 1.15 \times 10^{-7} \text{ cm}^3/\text{s}, \mu_p = 350 \text{ (cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}), k_0 = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}, q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}, T = 300 \text{ K})$$

五、导出二极管的正向电流与 V/V_D 的函数关系，此处 V 为外加电压，
并求 300K 时二极管的正向电流为 1A 时的外加电压值。

(设 $\mu_p=200 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$, $\mu_n=500 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$, $\tau_n=\tau_p=1\mu\text{s}$,
 $N_A=10^{15} \text{ cm}^{-3}$, $N_D=10^{16} \text{ cm}^{-3}$, PN 结面积为 $1.44 \times 10^{-2} \text{ cm}^2$) (20 分)

六、施主浓度 $N_D=10^{17}/\text{cm}^3$ 的 n 型硅, $N_c=2.8 \times 10^{19}/\text{cm}^3$ (如图), 求
室温下的功函数。 (15 分)

若不考虑表面态的影响, 它分别同
Al、Au、Mo 接触, 是形成阻挡
层还是反阻挡层? 硅的电子亲合能
取 4.05eV。设 $W_{Al}=4.18\text{eV}$,
 $W_{Au}=5.20\text{eV}$, $W_{Mo}=4.21\text{eV}$

